

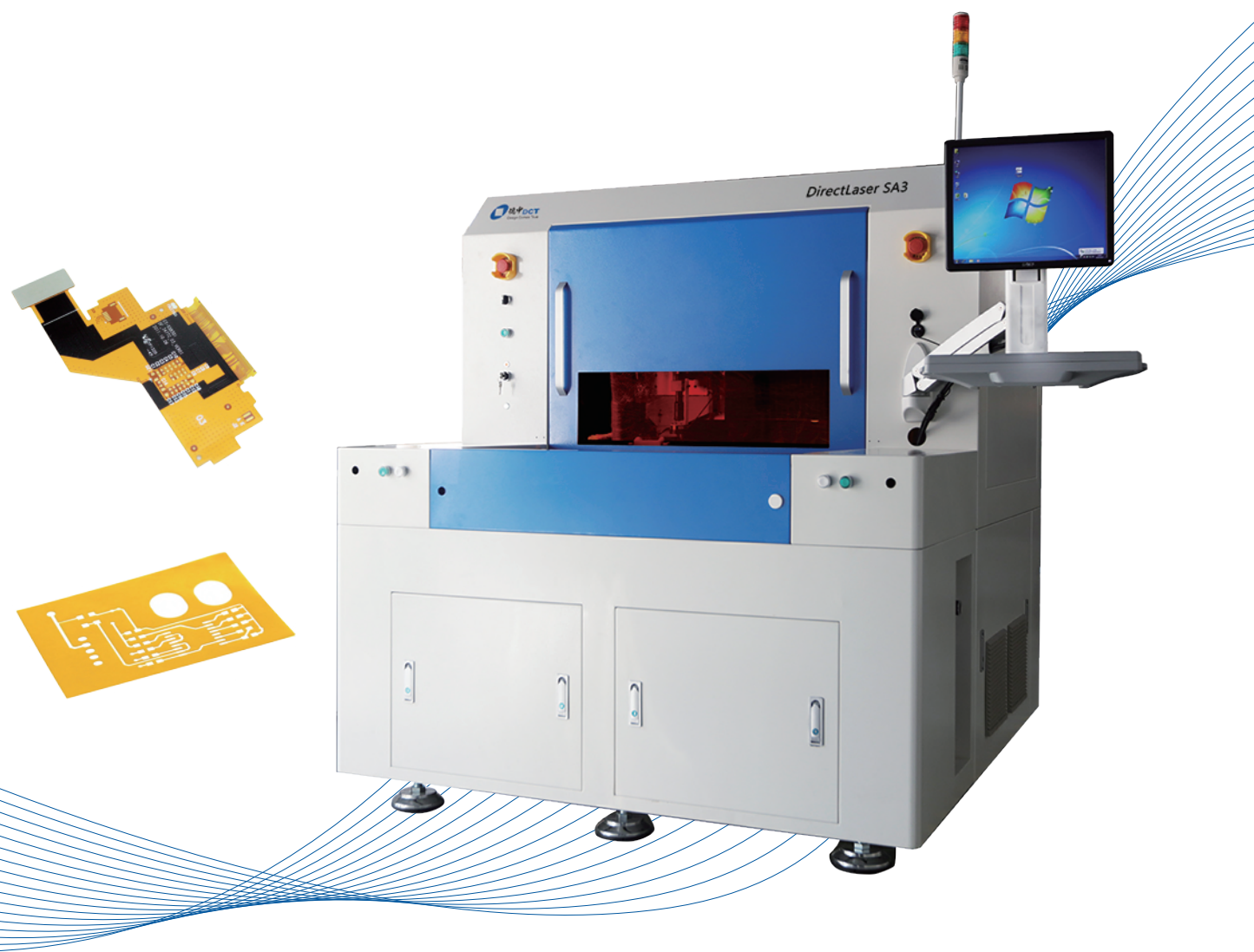
# 德中DirectLaser SA3/SF8

## 双平台激光精密切割系统

Double platform-Precise laser cutting system

SA3-常规幅面，灵活紧凑，性价比新标尺

SF8-超大幅面，全局适配，拓展应用范围



- 直接数据驱动，快速导入，产品切换迅速
- 激光替代模具，按需加工，突破机械极限
- 精确激光控制，工艺融合，精度效率并重
- 模块设计组装，结构紧凑，拓展维护便捷
- 操作简单快捷，引导操作，迅速导入生产
- 平台交替加工，提升效率，取放快速高效

适合裸板（PCB/FPC）和成品电路板（PCBA）各类加工任务，作为激光加工多面手，除满足PCBA分板及FPC覆盖膜开窗、外型切割、定深加工等切割应用，还可胜任简单钻孔加工。品种变换频率越高、电路板形状越复杂、孔越密越小，激光加工的优势就越突出，商业机会就越多。

### 模块化设计组装

机台、激光模块化设计组装，激光多自由度选择，根据材料特性和加工质量要求，可配置多种波长（紫外、绿光等）及脉宽（纳秒、皮秒等）激光器；丰富高阶选配（飞行加工、在线功率模块等）随应用需求增减，配置灵活。

### 适应多种应用场景

既适合各种厚度的软板、硬板、软硬结合板精密切割钻孔，也适合其他材料如：玻璃、陶瓷、薄金属板等材料的切割钻孔，还可激光直接成型电路板、修工艺导线等。

### 业内独有数据处理软件 CircuitCAM Laser

30年历史，为直接加工技术的发展奠定了基础，装机量远超万套；Laser版本横空出世：可满足激光精密激光切割、激光钻孔等各类激光加工应用，可自动生成激光加工路径，配备组合加工方案可以根据需求进行激光参数、加工路径优化选择，明显提升加工质量和速度，减少生产流程，降低成本。

### 速度—效率—精度”三者兼顾

高速运动控制系统配合CCD对位系统，保证加工过程高速高精度加工；融合完备精度校准体系，根据机型和配置不同，辅以涨缩、高度、功率补偿等，突破极限，又快又准。

### 双平台配置

可增加预对位、AOI等附加功能，实现抓靶、检测、切割分离，全面升级切割生产流程；可提供双光路配置，极大提升切割效率。

### 智能+安全，智能工厂标配

系统设置了标准工业接口，可集成到MES系统中，它支持操作数据的采集、机器分配、产品跟踪及配送。加工中区域全封闭，保证加工过程的安全防护；可选配多种自动化上下料，构成微型生产线。



技术参数	DirectLaser SA3	DirectLaser SF8
最大加工区域	2*350mm*520mm	2*550mm*550mm
设备平台	花岗岩平台, 直线电机	花岗岩平台, 直线电机
X/Y/Z轴移动分辨率	1μm	1μm
重复定位精度	±2μm	±2μm
激光器	飞秒、纳秒、红外、紫外、绿光可选	飞秒、纳秒、红外、紫外、绿光可选
自动上下料系统	选配	选配
摄像头靶标对位系统	标配	标配
工业吸尘系统	选配	选配
设备尺寸（W x H x D）	2,100mm x 1,600mm x 1,600mm	1,750mm x 2,050mm x 1,750mm
设备重量	2,000kg	2,800kg
电源	380VAC/50Hz,3.5kW	380VAC/50Hz,7.5kW
环境温度	22℃±2℃	22℃±2℃

参数更改，恕不另行通知



德中（天津）技术发展股份有限公司

天津市西青区海泰华科一路11号C座 Tel.: 022 83726901 Fax: 022 83726903

Http://www.dct-china.cn Email:sales@dct-china.cn